



フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザー (FE-EPMA)



フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザー(Field emission electron probe micro-analyzer: FE-EPMA)はショットキー電子銃によ り高電流で微小プローブを得られるため高空間分解能で観察が可能です。 また波長分散型X線分光(WDS)の高エネルギー分解能(約10 eV)でB~ Uの特性X線を検出できます(EDSの分解能は約130 eV)。座標リンク機能 を用いると測定座標を記憶でき効率的な実験ができます。ZAF法や薄膜定 量法(PRZ法)によりバルクや薄膜の定量分析も可能です。またEBSD(Electron back scattering diffraction)を備え結晶方位を把握できます。



【この装置でできること】 ・SEM観察(二次電子像観察、 反射電子像観察など)

東北大学

・WDS分析(定量分析、ライン 分析、面分析、薄膜の定量分析 (PRZ法)など)

・EBSD分析(結晶方位、結晶 粒径、結晶粒形状等OIM観察)

当センターのFE-EPMA (JXA-8530F, JEOL)外観と得られる情報



表1	本装置のWDS分光結晶 /	′分光素子の構成
-1-C -		

Ch1	Ch2	Ch3	Ch4
LIF	TAP	LDE1H	LIFH
PETJ	LDE2	LDE2H	PETH

LIF (Lithium Fluoride), PET (Pentaerythritol), TAP (Thallium acid phthalate)、H型はローランド

円の径が小さく、分析範囲は狭く、エネルギー分解能は悪いが、特性X線強度は大きくなる

表2 各分光結晶 / 分光素子の検出可能元素

結晶または 分光素子	面間隔 2d(nm)	検出元素(K線)	検出元素(L線)	検出元素(M線)
LIF	0.4027	K~Rb(H型:Ca~Ga)	Cd~U(H型はSn~Au)	-
PET	0.8742	Al ~ Mn (H型はSi~Ti)	Kr ~ Tb (H型はRb~Ba)	Yb~U(H型はHf~U)
TAP	2.5757	O ~ P	Cr ~ Nb	La ~ Au
LDE1	≒6	N, O, (FはH型は不可)	-	-
LDE2	≒ 10	B, C, N, (Oも可)	-	-



観察と分析の例

【反射電子像(BSE像)】 照射電子のうち弾性散乱した高エネルギーの反射 電子像で原子番号が大きいほど発生する反射電子 量が多く、組成の違いを知ることができます。

図2 反射電子像(鋼材と銅合金バイメタル)



【二次電子像(SE像)】

照射電子(一次電子が試料に衝突後に表面から二 次的に発生する低エネルギーの電子を二次電子検 出器で検出した像で、試料の凹凸が判ります。

図3 二次電子像(ビッカース圧痕)



【線分析(ライン分析)】 試料面内で電子線を一直線にスキャンした時に



【定性分析】 定性分析では、分光結晶位置(L値:エ ネルギーに換算される値)を全範囲スキャンすること で検出される特性X線から未知試料にどのような元素 が含まれているかがわかります。左の例ではCr, Mn, Fe, Ni が検出されています。

図6 SUS304の定性分析結果

 Curr. (A)
 : 2.000E-008

 Element
 Peak (mm)
 Net (cps)
 Bg Bg+
 S. D. (%)
 D. L. (ppm)
 K-raw (%)

 1
 Fe
 134.771
 3548.7
 13.8
 9.6
 0.53
 303
 70.358

 2
 Cr
 159.322
 799.0
 6.4
 7.8
 1.13
 323
 21.627

 3
 Si
 77.692
 143.2
 70.6
 44.4
 3.55
 62
 0.263

 4
 Mn
 146.539
 153.5
 45.8
 38.0
 3.17
 200
 1.061

 5
 Ni
 115.778
 982.2
 86.2
 72.0
 1.09
 285
 7.026

al Mass (%) Atom (%)

 mass (m)
 RCm/m
 RCm/m

【定量分析】定量分析ではバルク用ZAF補正と薄膜用 PRZ補正を用い、組成既知の標準試料を参照して定量 します。また、薄膜用のPRZ法では標準試料に加え、 試料作製に用いた基板(薄膜が載っていない試料)が 必要です。

2022.8作成

発生した特性X線の強度の変化から直線上での元 素の分布が判ります。

7. 371 6. 9110 7. 026 7. 026 1. 0395 0. 9856 1. 0547 1. 0000

otal 100.000 100.0000 100.334 100.334 Iteration = 4

図7 SUS304の定量分析結果

図4 反射電子像(a)とラインプロファイル(b)
 :(b)は(a)の黄色線に沿って分析したCuとSiの分布
 で、(a)でdarkな領域にはSiが、brightの領域には
 Cuが濃化していることが判る。



【面分析(元素マッピング)】 面分析を行うことで観察面内で試料に含 まれている複数の元素がどのように分布 しているかを知ることができます。

図5 鋼材と銅合金接合材のWDS分析 (a) Fe, (b) Si, (c) Cu, (d) Al : 界面から鋼材側に 柱状晶が発達しAlとSiが濃化。 【EBSD分析】70°傾斜した試料面に電子線を照射して発生する反射電子によるEBSDパタ ーンを用いて面方位を指数付けし、OIM(Orientation Imaging Mapping)と称します。



図8 Niの分析例:(a) ND方向逆極点図マップ、(b) Image quality (IQ) マップ、(c) 001正極点図

連絡先 附属新素材共同研究開発センター 技術職員 成田一生 Issei Narita TEL: 022-215-2375 (居室 2-210), FAX: 022-215-2157, E-mail: issei.narita.b4@tohoku.ac.jp